

# MEIKO REPORT

# 5G

## 第45期 第2四半期 株主通信

(2019年4月1日から2019年9月30日)

証券コード：6787

株式会社 **メイコー**

### 財務ハイライト

売上高

**59,122** 百万円

営業利益

**3,410** 百万円

親会社株主に帰属する四半期純利益

**2,366** 百万円

#### 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2019年3月31日現在	当第2四半期末 2019年9月30日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産	56,021	60,563
固定資産	64,634	66,065
有形固定資産	58,553	61,178
無形固定資産	269	314
投資その他の資産	5,811	4,573
資産合計	120,655	126,629
<b>負債の部</b>		
流動負債	47,932	50,287
固定負債	39,135	44,300
負債合計	87,068	94,588
<b>純資産の部</b>		
株主資本	30,446	32,288
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	6,464	6,464
利益剰余金	11,489	13,332
自己株式	△396	△396
その他の包括利益累計額	3,141	△248
その他の有価証券評価差額金	△65	11
繰延ヘッジ損益	183	92
為替換算調整勘定	3,322	△76
退職給付に係る調整累計額	△298	△276
純資産合計	33,587	32,040
負債純資産合計	120,655	126,629

#### 連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期(累計) 2018年4月1日～ 2018年9月30日	当第2四半期(累計) 2019年4月1日～ 2019年9月30日
売上高	61,758	59,122
売上原価	50,339	49,961
売上総利益	11,418	9,160
販売費及び一般管理費	5,744	5,749
営業利益	5,674	3,410
営業外収益	1,641	266
営業外費用	970	654
経常利益	6,345	3,022
特別利益	1	3
特別損失	129	182
税金等調整前四半期純利益	6,217	2,842
法人税等	886	476
四半期純利益	5,331	2,366
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,331	2,366

#### 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期(累計) 2018年4月1日～ 2018年9月30日	当第2四半期(累計) 2019年4月1日～ 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,900	4,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,153	△8,899
財務活動によるキャッシュ・フロー	△774	5,828
現金及び現金同等物に係る換算差額	153	△382
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,873	1,027
現金及び現金同等物の期首残高	15,190	11,419
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,316	12,446

### 財務のポイント

#### ●連結損益計算書

車載向け基板分野は、電装化の流れとビルドアップ化を含めた高多層化を背景に好調に推移しており、前年同期比で7億円の増収となりました。スマートフォン向け基板分野は、生産量が減少しており、前年同期比で46億円の減収となりました。その他分野の基板は、IoT/AI家電向け基板とアミューズメント向けビルドアップ基板の受注が好調に推移した結果、前年同期比で21億円増加しました。

その結果、当第2四半期の連結業績は売上高59,122百万円(前年同期比4.3%減)と前年同期に比べ2,636百万円の減収となりました。損益面では、営業利益3,410百万円(同39.9%減)、経常利益3,022百万円(同52.4%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益2,366百万円(同55.6%減)となりました。

#### ●連結貸借対照表

総資産は1,266億29百万円となり、前期末に比べ59億73百万円増加しました。これは流動資産において現金及び預金が10億49百万円増加、受取手形及び売掛金が20億15百万円増加、たな卸資産が12億21百万円増加、固定資産において有形固定資産が26億24百万円増加、投資その他の資産が12億37百万円減少したことが主な要因です。

純資産は320億40百万円となり、前期末に比べ15億47百万円減少しました。これは利益剰余金が18億42百万円増加、為替換算調整勘定が33億98百万円減少したことが主な要因です。



## 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。2019年3月期上期の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佑一郎**

2019年度上期 連結実績 (単位: 億円)

	2019年度上期実績		前年比	
	2018年度上期実績	2019年度上期実績	増減額	増減率
売上高	618	591	-27	-4.3%
営業利益	57 9.2%	34 5.8%	-23	-39.9%
経常利益	63 10.2%	30 5.1%	-33	-52.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	53 8.6%	24 4.0%	-29	-55.6%
為替 YEN/USD	110.64	108.66		

### 上期の業績について

当第2四半期連結累計期間における電子部品業界は、世界景気の減速や顧客の在庫調整などの影響により弱含みで推移いたしました。こうした中において5Gの立ち上がりを迎え、基地局需要を手始めにスマートフォンや自動運転分野などへの波及が見込まれており、徐々に受注環境の改善に向かうことが期待されております。

このような状況の中、当社グループでは5G時代の到来に向け次世代の自動車、スマートフォン、IoT/AI家電の案件が増加しつつありますが、当第2四半期連結累計期間においては、スマートフォン市場の低迷の影響を受けました。車載向け基板は、電装化の流れとビルドアップ化を含めた高多層化を背景に好調に推移しており、前年同期比で7億円の増収となりました。スマートフォン向け基板は、生産量が減少しており、前年同期比で46億円の減収となりました。その他分野の基板は、IoT/AI家電向け基板とアミューズメント向けビルドアップ基板の受注が好調に推移した結果、前年同期比で12億円増加しました。

2019年度上期 製品別収益 (単位: 億円)

	2018年度上期		2019年度上期		前年比	
	売上	営業利益 営業利益率	売上	営業利益 営業利益率	売上 伸び率	営業利益 伸び率
車載	267	19 7.1%	274	15 5.5%	7 2.6%	-4 -21.1%
スマートフォン	193	29 14.5%	147	14 9.5%	-46 -23.8%	-15 -51.7%
その他	158	9 5.9%	170	5 2.9%	12 7.6%	-4 -44.4%
合計	618	57 9.2%	591	34 5.8%	-27 -4.3%	-23 -39.9%

2019年度 連結業績予想 (単位: 億円)

	2019年度 予想	2019年度 上期実績	2019年度 下期予想
売上高	1,200	591	609
営業利益 営業利益率	75 6.3%	34 5.8%	41 6.7%
経常利益 経常利益率	63 5.3%	30 5.1%	33 5.4%
親会社株主に帰属する当期純利益 当期純利益率	53 4.4%	24 4.0%	29 4.7%
為替 YEN/USD	111.00	108.66	108.00

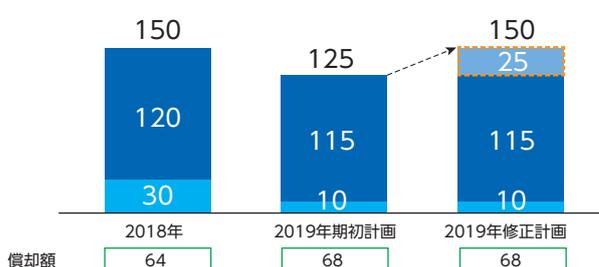
### 下期の見通しについて

当社グループの下期の販売は、車載向け基板は、電装化・電動化の進行により上期並みの販売を見込んでおります。スマートフォン向けの基板は、下期後半より5Gスマートフォン案件が徐々に増加することから上期並みの販売を見込んでおります。その他基板の分野は、引き続きIoT/AI家電向けの基板が好調に推移いたします。EMS事業においては、生産キャパシティの増加対策としてマイコー+和田ベトナムの子会社化などの強化策を実行しており販売が増加する見込みとなっております。

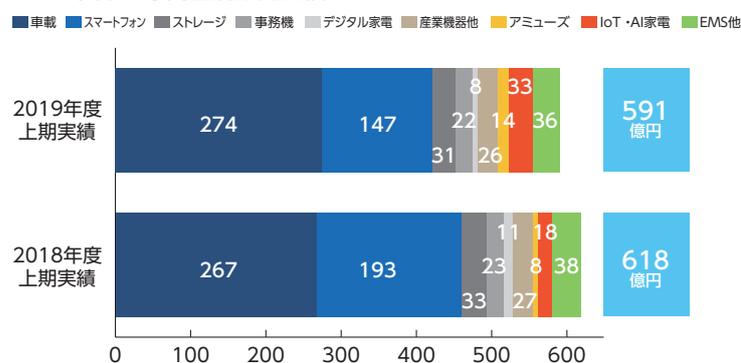
### 投資の状況について

当期の投資予定額を125億円から150億円とし、25億円追加することといたしました。この内訳としては、EMS分野の合併会社への出資あるいは、受注拡大を見越した設備増強を実施してまいります。このほかにも、5G案件の増加を見越した生産設備の増強を進めてまいります。

投資計画 (単位: 億円)



2019年度上期 商品別販売実績 (単位: 億円)



2019年度上期 仕様別販売実績 (単位: 億円)



ベトナムにおける工場戦略について

第1工場はフレキ・EMSの工場ですが、一部のスペースで中国のODMメーカーである龍旗社との合併事業として最終製品の組立事業を行うほか、ファブレス企業へのEMS事業の提案強化を推進してまいります。フレキシブル基板については車載、スマートフォンおよびアミューズメント向けなど多様な販路の拡大を進めており、生産規模を拡大する施策を推進しております。

第2工場は車載の専用工場として再整備を行い、自動車向けの貫通基板とビルドアップ基板の生産に特化して生産性の向上を図ってまいります。

第3工場はMSAP工法のビルドアップ基板の生産ラインを導入いたしました。このラインではハイエンドのスマートフォンや5G対応のスマートフォンの生産を拡大する施策を推進しております。このほかに、次世代の自動車に必要な基板として、ADAS用途にミリ波レーダー基板、電動車用途にパワーデバイス基板、放熱用途に超厚銅基板や銅ピン基板など次世代の車載向け基板の生産を行う工場として整備してまいります。

タンロン工場は、スマートフォン向けの基板の生産を行っていますが、この先市場の拡大が見込まれる高周波モジュールの生産に対応する工場として整備してまいります。

メイコー+和田ベトナムにおいては、高周波モジュールの実装などEMS事業の拡大を担う工場として整備してまいります。

5Gがもたらす変革について

5G通信がもたらすメリットは、通信が高速であること、多数の端末を同時に接続できること、ネットワーク遅延が小さいことなどがあげられます。このメリットを生かす分野として、スマートフォンの高速化、自動車における自動運転・車両間通信、IoT分野での活用、遠隔監視や遠隔医療など生活に身近な分野での活用が進行し生活環境に変化をもたらすことが予想されております。これに対するプリント基板には、高精細な仕様が要求されます。例えば、現在のスマートフォンではラインアンドスペース(L/S)が40~50μですが、5G通信モジュールでは25μとなりより高精細化する見込みとなっております。これに対応するために必要なMSAPラインの導入を完了いたしました。この他にも、車載向け基板では、自動運転に不可欠なミリ波レーダーやコネクテッドカーで使用される通信モジュールなどへの対応も推進してまいります。また、5Gに関連する需要は、プリント基板の使用量の拡大を伴い増加します。これは、プリント基板の後工程であるEMS事業にもビジネスチャンスを生んでいます。当社はプリント基板の商談をコアに、EMS領域の案件をキャッチアップし新たな事業施策や業績の拡大を積極的に図ってまいります。

株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーのご支援、ご期待に応えるべく、新規施策や改善に全力で取り組み、業績と企業価値の向上に努めてまいります。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



**フレキ**

**龍旗社合併**

**IoT/AI家電**

**第1工場**

**フレキ・EMS**



**車載貫通**

**車載ビルド**

**第2工場**

**車載専用工場**



**スマホ**

**5Gスマホ**

**車載開発品**

**第3工場**

**MSAP・車載開発品**



**スマホ**

**高周波モジュール**

**タンロン工場**

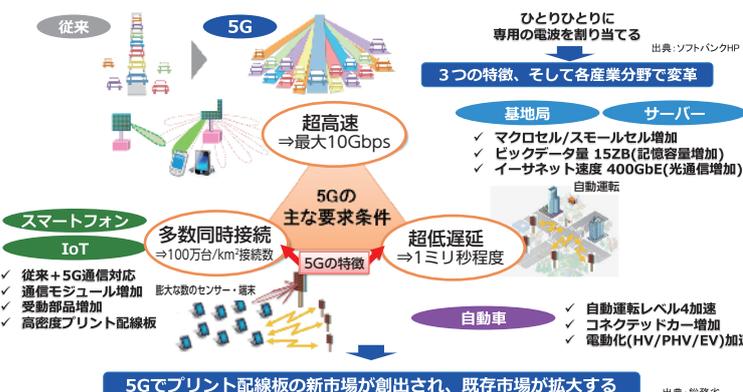
**高周波モジュール**



**高周波モジュール**

**メイコー+和田ベトナム**

**EMS**



	700MHz	3.6GHz	6GHz	28GHz	ミリ波
通信システム	従来通信	5G通信	5G通信	5G通信	5G通信
基地局	マクロセル / スモールセル / 高周波モジュール (高多層 高周波基板)				
サーバー	サーバー-SSD (10層)	サーバー-SSD (10層)	データセンター-SSD (16層 高周波基板)	データセンター-SSD (16層 高周波基板)	データセンター-SSD (16層 高周波基板)
スマートフォン	メインボード (L/S=50/50um)	メインボード (L/S=50/50um)	メインボード (MSAP L/S=30/30um → 25/25um)	メインボード (MSAP L/S=25/25um)	メインボード (MSAP L/S=25/25um)
IoT	通信モジュール (L/S=35/35um)	通信モジュール (L/S=35/35um)	通信モジュール (MSAP L/S=25/25um)	通信モジュール (MSAP L/S=25/25um)	通信モジュール (MSAP L/S=25/25um)
自動運転	ミリ波レーダー (MSAP 高周波基板)	ミリ波レーダー (MSAP 高周波基板)	TCU/V2X通信モジュール (12層エニールレイヤー)	TCU/V2X通信モジュール (12層エニールレイヤー)	TCU/V2X通信モジュール (12層エニールレイヤー)
電動化	パワーデバイス (銅インレイ 厚銅基板)	パワーデバイス (銅インレイ 厚銅基板)	IVI(インフォテインメント) (3段ビルドアップ)	IVI(インフォテインメント) (3段ビルドアップ)	IVI(インフォテインメント) (3段ビルドアップ)
コネクテッドカー	コネクテッドカー	コネクテッドカー	コネクテッドカー	コネクテッドカー	コネクテッドカー
自動運転	レベル2	レベル2	レベル3	レベル3	レベル4
	2019年	2020年	2020年	2020年	2025年



常勤監査役  
露木豊彦

2019年6月の株主総会で選任して頂き、常任監査役として職務を遂行させて頂いています。近年、監査役の役割が非常に重要視されています。より内部統制の整備や現場に近い監査を行い、執行側にも監査役の立場から率直な意見や助言を行うことによって、少しでも当社の発展に寄与できるよう努めてまいります。

当社は、ベトナムに第3工場を建設し、スマート化による高品質、高生産化を進めており間接部門でも革新的生産性改善プロジェクトを立ち上げ、全社的な改善を推進しています。

今後も監査を通じて、株主をはじめとするステークホルダーの皆様のご期待に沿えるよう、当社の企業価値の向上に貢献したいと思っておりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## コーポレートデータ (2019年9月30日現在)

### 会社概要

商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	11,843名(連結) (国内856名・海外10,987名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

### 役員

代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
取締役専務執行役員	平山 隆英
取締役専務執行役員	篠崎 政邦
取締役常務執行役員	松田 孝広
取締役常務執行役員	和田 純也
取締役	申 允浩
取締役	土屋 奈生
取締役	西山 洋介
常勤監査役	露木 豊彦
監査役	原田 隆
監査役	佐藤 孝幸

### 関連会社

株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテクノ	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業
Meiko Electronics Europe GmbH	電子関連事業

### 株式情報

発行可能株式総数	70,000,000株
発行済株式の総数 (自己株式 629,427株を除く)	26,173,893株
株主数	5,896名

### 大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,703	17.97
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,383	9.11
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,297	4.96
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC /FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	950	3.63
名幸興産株式会社	608	2.32
有限会社ユーホー	521	1.99
野村信託銀行株式会社(投信口)	481	1.84
名屋 精一	435	1.66
JP MORGAN CHASE BANK 385632	427	1.63
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019	404	1.55

※当社は、自己株式 629,427株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 所有者別株式分布状況(普通株式)



### 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
上場証券取引所	東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)
公告の方法	電子公告により当社ウェブサイトに掲載 <a href="https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml">https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml</a> ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

### 株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15 ホームページ <https://www.meiko-elec.com/>  
TEL: 0467 (76) 6001 (大代表)

### 見直しに関する注意事項

本報告書に記載されている情報につきましては、当社の計画、業績など将来の見直しに関する記述が含まれており、これらの記述は、その時点で入手可能な情報および当社が合理的であると判断する一定の前提条件に基づいています。実際の業績は、さまざまな要素により、これらと異なる結果となり得ることをご承知おきください。



この冊子は環境保全のため、植物油インキとFSC®認証紙を使用しています。見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。